



Printed circuit board recycling: a focus on a novel, efficient and sustainable process for spent critical metals recovery

Nicolas M. Charpentier^{®, a}, Dong Xia^{®, b} and Jean-Christophe P. Gabriel^{®, *, a, b}

^a Université Paris-Saclay, CEA, CNRS, NIMBE, LICSEN, 91191, Gif-sur-Yvette, France

^b SCARCE Laboratory, Energy Research Institute @ NTU (ERI@N), Nanyang Technological University, 637553, Singapore

E-mail: jean-christophe.gabriel@cea.fr (J.-C. P. Gabriel)

* Corresponding author.

Supplementary Table S1. Metal content of different PCBs from different referenced studies

Metal content	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[12]	[12]	[13]	[14]	
Cu (%)	19	20	22	12.5	26.8	15.6	19.66	28.7	27.6	14.6	14.2	18.84	24.19	14.52	16.3	18.01	12.37
Al (%)	4.1	2	—	2.04	4.7	—	2.88	1.7	—	—	—	—	—	—	—	12.63	10.1
Pb (%)	1.9	2	1.55	2.7	—	1.35	3.93	1.3	—	2.96	2.5	0.71	1.13	0.4	0.27	—	0.013
Zn (%)	0.8	1	—	0.08	1.5	0.16	2.1	—	2.7	—	0.18	—	—	—	—	1.13	8
Ni (%)	0.8	2	0.32	0.7	0.47	0.28	0.38	—	0.3	1.65	0.41	0.69	0.43	1.13	0.89	—	4.05
Fe (%)	3.6	8	3.6	0.6	5.3	1.4	11.47	0.6	2.9	4.79	3.08	0.18	0.17	0.19	0.1	0.54	10.4
Sn (%)	1.1	4	2.6	4	1	3.24	3.68	3.8	—	5.62	4.79	1.81	1.46	1.23	1.56	1.01	—
Sb (%)	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—
Cr (%)	—	—	—	—	—	—	0.005	—	—	0.356	—	—	—	—	—	—	—
Na (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	—	—	—	—	—	—
Ca (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.13	—	1.4	—	1.69	—	—	—	7.99
Ba (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.05
Ag (ppm)	5210	2000	—	300	3300	1240	500	79	—	450	317	900	0	0	0	—	1900
Au (ppm)	1120	1000	350	—	80	420	300	68	—	205	142	4200	2000	2400	900	—	200
Pt (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Cd (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1183	—	—	—	—	—
K (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	—	—	—	—	—
In (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Mn (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	9700	—	4000	—	81	—	—	—	—
Se (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—
As (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—
Mg (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pd (ppm)	—	50	—	—	—	—	—	33	—	220	—	—	—	—	—	—	—
Co (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	—	—	—	—	—	—	—
Ti (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ta (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800	0	0	0	—	—
REEs (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.47	—
Total metals (%)	31.9	39.3	30.1	22.6	40.2	22.2	46.5	36.1	35.3	30.1	27.6	22.8	27.6	17.7	19.2	44.4	45.1

(continued on next page)

Supplementary Table S1. (continued)

Metal content	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	Average	Standard Dev.
Cu (%)	12.58	19.19	28.00	34.49	37.18	41.00	11.53	41.76	43.19	22.3	9.5
Al (%)	2.38	7.06	2.60	0.26	0.61	0.68	1.13	2.78	3.7	3.3	
Pb (%)	2.44	1.01		1.87	7.87	6.29	0.12	11.83	2.5	2.7	
Zn (%)		0.73		5.92	1.82	5.00	1.04	0.33	14.25	2.5	3.6
Ni (%)	0.39	5.35	0.26	2.63	2.54	7.00	0.32	2.92	13.44	2.0	2.9
Fe (%)	3.24	3.56	0.08	10.57	4.85	38.00	—	44.76	13.90	6.4	10.4
Sn (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.5
Sb (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0
Cr (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2
Na (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	N/A
Ca (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.3
Ba (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	N/A
Ag (ppm)	—	2000	130.0	—	—	5200.0	1400.0	100.0	1171.0	1570.3	
Au (ppm)	—	700	29.0	—	—	3100.0	1300.0	3100.0	991.5	1210.2	
Pt (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	N/A
Cd (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1183.0	N/A
K (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180.0	N/A
In (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500.0	N/A
Mn (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4593.7	4836.9
Se (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	N/A
As (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	N/A
Mg (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750.0	353.6
Pd (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	103.4
Co (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350.0	70.7
Ti (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400.0	N/A
Ta (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200.0	400.0
REEs (ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	N/A
Total Metals (%)	21.0	37.2	31.0	55.7	54.9	91.0	20.7	91.3	99.7	38.5	21.4

References

- [1] A. V. Feldman, "Method for processing scrap of electronic instruments", 1993, US Patent US5217171A.
- [2] R. P. Menetti, S. A. J. Tenório, *Proceedings of the 50th Annual Congress of ABM, São Pedro, SP Brazil*, 1995, 1-4 pages.
- [3] M. Iji, S. Yokoyama, *Circuit World*, 1997, **23**, 10-15.
- [4] H. M. Veit, C. C. de Pereira, A. M. Bernardes, *JOM*, 2002, **54**, 45-47.
- [5] Y. Zhao, X. Wen, B. Li, D. Tao, *Minin. Metall. Explor.*, 2004, **21**, 99-102.
- [6] B.-S. Kim, J. Lee, S.-P. Seo, Y.-K. Park, H. Y. Sohn, *JOM*, 2004, **56**, 55-58.
- [7] H. Wang, G. Gu, Y. Qi, *J. Cent. South Univ. Technol.*, 2005, **12**, 552-555.
- [8] N. J. Creamer, V. S. Baxter-Plant, J. Henderson, M. Potter, L. E. Macaskie, *Biotechnol. Lett.*, 2006, **28**, 1475-1484.
- [9] I. de Marco *et al.*, *J. Anal. Appl. Pyrolysis*, 2008, **82**, 179-183.
- [10] T. Hino, R. Agawa, Y. Moriya, M. Nishida, Y. Tsugita, T. Araki, *J. Mater. Cycles Waste Manag.*, 2009, **11**, 42-54.
- [11] W. A. Bizzo, R. A. Figueiredo, V. F. De Andrade, *Materials (Basel)*, 2014, **7**, 4555-4566.
- [12] F. Cucchiella, I. D'Adamo, P. Rosa, S. Terzi, *J. Clean. Prod.*, 2016, **121**, 130-141.
- [13] A. Popović, V. Manojlović, B. Adnadjević, J. Petrović, Ž. Kamberović, Ranitović, M., *Processes*, 2022, **10**, article no. 1152.
- [14] M. Schluep, P. des Nations Unies pour l'environnement, *Recycling, from E-waste to Resources*, UNEP DTIE; StEP Initiative, 2009.
- [15] A. Das, A. Vidyadhar, S. P. Mehrotra, *Resour. Conserv. Recycl.*, 2009, **53**, 464-469.
- [16] J.-M. Yoo, J. Jeong, K. Yoo, J. Lee, W. Kim, *Waste Manag.*, 2009, **29**, 1132-1137.
- [17] P. C. Oliveira, M. Cabral, C. A. Nogueira, F. Margarido, *Mater. Sci. Forum*, 2010, **636-637**, 1434-1439.
- [18] L. H. Yamane, V. T. de Moraes, D. C. R. Espinosa, J. A. S. Tenório, *Waste Manag.*, 2011, **31**, 2553-2558.
- [19] A. C. Kasper, G. B. T. Berselli, B. D. Freitas, J. A. S. Tenório, A. M. Bernardes, H. M. Veit, *Waste Manag.*, 2011, **31**, 2536-2545.
- [20] Y. Kim, H. Seo, Y. Roh, *Minerals*, 2018, **8**, article no. 8.
- [21] A. Priya, S. Hait, *Waste Manag.*, 2018, **75**, 103-123.
- [22] D. Fontana, M. Pietrantonio, S. Pucciarmati, C. Rao, F. Forte, *Waste Manag.*, 2019, **99**, 22-30.
- [23] M. Annamalai, K. Gurumurthy, *J. Air Waste Manag. Assoc.*, 2021, **71**, 315-327.